



Có phải các công nghệ chip và IC chính xác cao làm gia tăng chi phí sản xuất đồng thời giảm năng suất chế tạo dẫn đến giảm lợi nhuận?

Máy Universal Instruments' FuzionSC™ mang đến giải pháp toàn diện để đóng gói chip lật bằng cách kết hợp giữa các yêu cầu chính xác nghiêm ngặt trong việc lắp ráp linh kiện bán dẫn với tốc độ và sự mạnh mẽ của Nền tảng Universal Fu Fusion. Với khả năng xử lý tất cả các khía cạnh trong lắp ráp chip lật, FuzionSC giảm chi phí vận hành và vốn đầu tư bằng cách tối đa hóa thông lượng trên mỗi không gian sàn.

- ✓ Lắp ráp tốc độ cao/độ chính xác cao cho silicon và dán dán bề mặt
- ✓ Độ chính xác cao: (độ lệch vị trí $\pm 10\mu\text{m}$, $< 3\mu\text{m}$)
- ✓ Đầu nhiều trục, trục đơn hoặc kép
- ✓ Ứng dụng cho tất cả các loại và kích cỡ linh kiện, mạch tích hợp
- ✓ Xử lý chất nền đa năng
- ✓ Bộ phận cấp đầu vào dài rộng nhất
- ✓ Chi phí bảo trì thấp, hoạt động ổn định lâu dài
- ✓ Nhận diện chính xác chân linh kiện hoặc đầu mạch hàn
- ✓ Hỗ trợ xếp chồng (POP)
- ✓ Có khả năng ứng dụng lực nhẹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC MODEL CỦA MÁY FUZIONSC

- **FuzionSC1-11** - Cấu hình linh hoạt tạo ra các giải pháp chế tạo bán dẫn chính xác, năng suất cao nhất. Ứng dụng cho dải linh kiện rộng lớn mà không cần phải cấu hình lại.
- **FuzionSC2-14** - Cấu hình sản xuất đại trà mang đến các giải pháp chế tạo bán dẫn chính xác, năng suất cao nhất. Duy trì tính linh hoạt vượt trội so với các giải pháp chuyên dụng để hỗ trợ thay đổi công nghệ.

Model	Năng suất tối đa (cph)	Độ chính xác ($\mu\text{m}@>1.00$ Cpk)	Kích thước bo mạch lớn nhất	Đầu cấp vào lớn nhất (8mm)	Dải linh kiện
FuzionSC1-11	16,500	± 10 (Array Devices/Flip Chip) / ± 38 (Passives/Chips)	508 x 813mm	120 (2 ULC)	0201 - 150mm sq, 25mm tall
FuzionSC2-14	30,750	± 10 (Array Devices/Flip Chip) / ± 38 (Passives/Chips)	508 x 813mm	120 (2 ULC)	0201 - 150mm sq, 25mm tall